**附件1 拟立项标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编号** | **标准名称** | **制修订** | **牵头申报单位** |
| 1 | CEMIA2022-1-001 | 厚膜集成电路用银钯导体浆料 | 制定 | 西安宏星电子浆料科技股份有限公司 |
| 2 | CEMIA2022-1-002 | 片式电阻器用低温固化包封浆料 | 制定 | 西安宏星电子浆料科技股份有限公司 |